

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	<div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</div></div>
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、东北证券以及个人投资者
时间	2025 年 7 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<div><div>1、2025Q2 稼动率水平？</div><div>Q2 稼动率相对 Q1 环比上升，产能趋于饱满。</div><div>2、二期项目未来投资规划？</div><div>公司二期规划总投资 110 亿，重投资的基建部分已基本完成，后续投资主要是先进封装的设备以及厂房装修，公司将根据终端市场的需求变化情况，审慎稳妥控制投资节奏。</div><div>3、2.5D 先进封装进展？</div><div>公司 2.5D 封装已于 2024 年四季度完成通线，目前正积极与客户进行产品验证。</div><div>4、车载 CIS 产品进展？</div><div>公司与车规领域头部客户合作的车载 CIS 已经稳定量产，稼动率相对比较饱满。</div><div>5、下游应用市场的景气度？</div><div>IoT 领域新的应用场景不断涌现，芯片应用范围越来越广，Q1 及 Q2 整体景气度持续提升，Q3 预计将保持上升趋势；车规领域增速较快，包括车载 CIS 及激光雷达等产品。</div></div>

	<p>6、未来研发投入规划？</p> <p>甬矽电子专注于中高端先进封装，围绕先进封装领域，公司研发投入持续提升，研发费用率大概维持在 6%左右的水平。</p> <p>7、设备国产化率情况？</p> <p>公司根据自身的工艺需求和客户的需求审慎进行设备选型，综合考虑量产的稳定性以及客户的接受度等角度，目前核心站别以进口设备为主。同时公司高度重视国产替代，主要站别均有相对应的国产设备的备选方案。</p> <p>8、二期扩产完成后预计稳态毛利率情况？</p> <p>公司期待的稳态毛利率在 25%~30%，与公司目前的产品结构规划相匹配。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 7 月 11 日